



2021年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年7月31日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3433 URL <https://www.tocalo.co.jp/>
 代表者(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三船 法行
 問合せ先責任者(役職名) 常務取締役管理本部長(氏名) 樽見 哲男 (TEL) 078-303-3433
 四半期報告書提出予定日 2020年8月11日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第1四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第1四半期	9,911	0.1	2,227	11.3	2,276	13.6	1,466	15.7
2020年3月期第1四半期	9,897	△11.0	2,001	△26.0	2,005	△26.8	1,267	△29.6

(注) 包括利益 2021年3月期第1四半期 1,478百万円(6.7%) 2020年3月期第1四半期 1,385百万円(△17.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第1四半期	24.12	—
2020年3月期第1四半期	20.85	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第1四半期	61,562	43,322	66.4
2020年3月期	61,122	42,634	65.9

(参考) 自己資本 2021年3月期第1四半期 40,893百万円 2020年3月期 40,263百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期	—	12.50	—	12.50	25.00
2021年3月期	—	—	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	12.50	—	12.50	25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	18,500	△1.6	3,300	△1.5	3,400	△0.1	2,170	1.0	35.69
通期	36,500	△3.7	5,800	△11.5	6,000	△11.9	3,880	△11.9	63.82

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 一社(社名) — 、除外 一社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

2021年3月期1Q	63,200,000株	2020年3月期	63,200,000株
2021年3月期1Q	2,405,136株	2020年3月期	2,405,136株
2021年3月期1Q	60,794,864株	2020年3月期1Q	60,794,884株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
3. その他	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで、以下「当第1四半期」という)の当社グループを取り巻く事業環境は、半導体・FPD(フラットパネルディスプレイ)分野においては堅調であったものの、新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞により、産業機械分野や鉄鋼分野で受注減並びに先送りの兆候も見られるなど、全般的に先行き不透明な状況が継続しております。

このような状況のもと、当社グループは、収益源の多角化を図るべく様々な営業活動を展開するとともに、生産効率の向上、新しい表面改質技術の開発に取り組んでまいりました。

当第1四半期における当社グループの連結業績につきましては、売上高は前年同期比14百万円(0.1%)増の99億11百万円、営業利益は同2億25百万円(11.3%)増の22億27百万円、経常利益は同2億71百万円(13.6%)増の22億76百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同1億98百万円(15.7%)増の14億66百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工(単体)]

新型コロナウイルス感染症の影響により、産業機械分野などで受注が落ち込む一方で、半導体・FPD分野は比較的好調に推移したため、当セグメントの売上高は前年同期比3億62百万円(4.8%)増の78億72百万円、セグメント利益(経常利益)は同3億26百万円(21.3%)増の18億59百万円となりました。

[国内子会社]

国内子会社(日本コーティングセンター株式会社)は、新型コロナウイルス感染症拡大による自動車生産一時停止の影響を受け、受注が大きく落ち込み、セグメントの売上高は前年同期比1億42百万円(23.6%)減の4億62百万円、セグメント利益(経常利益)は同66百万円(48.6%)減の70百万円となりました。

[海外子会社]

中国子会社において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、一時的に操業停止となったため、当セグメントの売上高は前年同期比1億41百万円(12.1%)減の10億30百万円、セグメント利益(経常利益)は同6百万円(1.8%)減の3億50百万円となりました。

[その他表面処理加工]

溶射加工(単体)、国内子会社、海外子会社以外のセグメントについては、総じて受注が弱含みで推移し、売上高の合計は前年同期比64百万円(10.6%)減の5億46百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同30百万円(36.1%)減の54百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は615億62百万円となり、前連結会計年度末比4億40百万円の増加となりました。これは、溶射加工(単体)において主に半導体・FPD分野の販売増に伴う売掛金の増加などにより流動資産が3億63百万円増加したことや、国内子会社の日本コーティングセンター株式会社において新工場建設のための土地取得や建設一時金の支払等もあり有形固定資産が2億36百万円増加したことなどによるものであります。

一方、当第1四半期連結会計期間末における負債は、182億40百万円と前連結会計年度末比2億47百万円減少いたしました。これは借入金の返済が進んだことなどによるものであります。

また、当第1四半期連結会計期間末における純資産は433億22百万円と前連結会計年度末比6億87百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加7億06百万円によるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.4%(前連結会計年度末比0.5ポイントの上昇)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染症の影響により、景気は全般的に先行き不透明な状況が継続しております。

半導体・FPD分野では、テレワーク、5G通信、IoT、AI、自動運転などの普及により、中長期的には需要が拡大基調で推移すると予想されるものの、予断を許さない環境にあります。

産業機械、鉄鋼など、半導体以外の分野では、製造業全般の設備投資先送りなどにより、厳しい受注環境が続くものと判断しております。

このような状況のもと、当社グループの2021年3月期の通期連結業績は、売上高365億円(前期比3.7%減)、営業利益58億円(同11.5%減)、経常利益60億円(同11.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益38億80百万円(同11.9%減)を見込んでおります。

また、当期の年間配当金につきましては、前期と同様、1株当たり25円(中間配当12円50銭、期末配当12円50銭、予想連結配当性向39.2%)とする予定であります。

なお、本日(2020年7月31日)公表の「連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」も併せてご参照ください。

・2021年3月期 通期 連結業績予想 (2020年4月1日～2021年3月31日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
今回発表予想	36,500	5,800	6,000	3,880	63.82
(ご参考) 前期実績 (2020年3月期)	37,896	6,550	6,812	4,404	72.45

※セグメント別予想連結売上

セグメントの名称	前連結会計年度(実績) (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度(予想) (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	比較増減	
	連結売上高 (百万円)	予想連結売上高 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	14,102	15,903	1,801	+12.8
産業機械用部品への加工	4,782	3,768	△ 1,013	△21.2
鉄鋼用設備部品への加工	3,899	3,400	△ 499	△12.8
その他の溶射加工	5,437	5,035	△ 401	△7.4
溶射加工(単体) 計	28,221	28,108	△ 113	△0.4
その他表面処理加工	2,384	1,987	△ 396	△16.6
国内子会社	2,364	1,986	△ 377	△16.0
海外子会社	4,925	4,417	△ 508	△10.3
合計	37,896	36,500	△ 1,396	△3.7

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	16,889	16,921
受取手形及び売掛金	11,712	11,983
仕掛品	1,105	1,153
原材料及び貯蔵品	1,476	1,725
その他	673	434
貸倒引当金	△20	△16
流動資産合計	31,837	32,200
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	12,416	12,283
機械装置及び運搬具（純額）	4,207	4,089
土地	8,648	8,923
その他（純額）	1,513	1,725
有形固定資産合計	26,786	27,022
無形固定資産	338	317
投資その他の資産		
投資その他の資産	2,160	2,022
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	2,160	2,022
固定資産合計	29,285	29,362
資産合計	61,122	61,562

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,157	1,088
電子記録債務	3,660	4,080
短期借入金	47	15
1年内返済予定の長期借入金	2,083	2,083
未払法人税等	737	666
賞与引当金	1,018	521
その他	2,619	3,133
流動負債合計	11,323	11,588
固定負債		
長期借入金	6,015	5,494
退職給付に係る負債	1,085	1,099
その他	63	57
固定負債合計	7,163	6,651
負債合計	18,487	18,240
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,658	2,658
資本剰余金	2,293	2,293
利益剰余金	35,898	36,605
自己株式	△773	△773
株主資本合計	40,076	40,783
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	△12	△11
為替換算調整勘定	198	122
その他の包括利益累計額合計	186	110
非支配株主持分	2,371	2,428
純資産合計	42,634	43,322
負債純資産合計	61,122	61,562

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位:百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)
売上高	9,897	9,911
売上原価	6,374	6,236
売上総利益	3,522	3,674
販売費及び一般管理費	1,520	1,447
営業利益	2,001	2,227
営業外収益		
受取利息及び配当金	1	1
受取ロイヤリティー	20	42
受取技術料	1	-
その他	18	15
営業外収益合計	41	59
営業外費用		
支払利息	4	3
技術者派遣費用	0	-
支払補償費	27	-
為替差損	4	4
その他	1	1
営業外費用合計	38	9
経常利益	2,005	2,276
特別利益		
固定資産売却益	0	0
保険解約返戻金	-	12
特別利益合計	0	13
特別損失		
固定資産除売却損	1	0
特別損失合計	1	0
税金等調整前四半期純利益	2,003	2,289
法人税等	634	697
四半期純利益	1,369	1,591
非支配株主に帰属する四半期純利益	101	125
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,267	1,466

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)
四半期純利益	1,369	1,591
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2	0
為替換算調整勘定	17	△113
その他の包括利益合計	15	△113
四半期包括利益	1,385	1,478
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,282	1,390
非支配株主に係る四半期包括利益	102	88

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

3. その他

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	前年同四半期比	
	生産高(百万円)	生産高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	3,525	4,537	1,011	+28.7
産業機械用部品への加工	1,419	1,164	△ 255	△18.0
鉄鋼用設備部品への加工	995	976	△ 18	△1.9
その他の溶射加工	1,568	1,193	△ 374	△23.9
溶射加工(単体) 計	7,509	7,872	362	+4.8
その他表面処理加工	610	546	△ 64	△10.6
国内子会社	605	462	△ 142	△23.6
海外子会社	1,171	1,030	△ 141	△12.1
合 計	9,897	9,911	14	+0.1

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自2019年4月1日 至2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自2020年4月1日 至2020年6月30日)	前年同四半期比	
	受注高(百万円)	受注高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	3,265	4,599	1,333	+40.8
産業機械用部品への加工	932	912	△19	△2.1
鉄鋼用設備部品への加工	1,151	861	△290	△25.2
その他の溶射加工	1,755	1,107	△647	△36.9
溶射加工(単体) 計	7,105	7,482	376	+5.3
その他表面処理加工	579	512	△67	△11.6
国内子会社	590	457	△132	△22.5
海外子会社	1,230	978	△251	△20.5
合計	9,506	9,430	△75	△0.8

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

(受注残高)

セグメントの名称	前第1四半期 連結会計期間末 (2019年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (2020年6月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(百万円)	受注残高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	1,903	2,939	1,036	+54.5
産業機械用部品への加工	415	356	△58	△14.0
鉄鋼用設備部品への加工	949	733	△215	△22.7
その他の溶射加工	635	397	△238	△37.5
溶射加工(単体) 計	3,903	4,428	524	+13.4
その他表面処理加工	230	211	△18	△8.1
国内子会社	35	33	△2	△7.6
海外子会社	1,520	1,042	△478	△31.4
合計	5,690	5,715	24	+0.4

(注) 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

③ 販売実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)	前年同四半期比	
	販売高(百万円)	販売高(百万円)	金額(百万円)	増減率 (%)
溶射加工(単体)				
半導体・FPD製造装置 用部品への加工	3,525	4,537	1,011	+28.7
産業機械用部品への加工	1,419	1,164	△ 255	△18.0
鉄鋼用設備部品への加工	995	976	△ 18	△1.9
その他の溶射加工	1,568	1,193	△ 374	△23.9
溶射加工(単体) 計	7,509	7,872	362	+4.8
その他表面処理加工	610	546	△ 64	△10.6
国内子会社	605	462	△ 142	△23.6
海外子会社	1,171	1,030	△ 141	△12.1
合 計	9,897	9,911	14	+0.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

以 上